

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成 21 年 6 月 25 日 (2009.6.25)

【公開番号】特開 2006-137954 (P2006-137954A)

【公開日】平成 18 年 6 月 1 日 (2006.6.1)

【年通号数】公開・登録公報 2006-021

【出願番号】特願 2005-331857 (P2005-331857)

【国際特許分類】

C 0 9 J 201/00 (2006.01)

C 0 9 J 9/02 (2006.01)

H 0 1 B 1/22 (2006.01)

H 0 5 K 3/32 (2006.01)

H 0 5 K 3/36 (2006.01)

C 0 9 J 11/00 (2006.01)

C 0 9 J 121/00 (2006.01)

【F I】

C 0 9 J 201/00

C 0 9 J 9/02

H 0 1 B 1/22 D

H 0 5 K 3/32 B

H 0 5 K 3/36 A

C 0 9 J 11/00

C 0 9 J 121/00

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 5 月 13 日 (2009.5.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

相対峙する回路電極を加熱、加圧によって、加圧方向の電極間を電氣的に接続する加熱接着性接着剤において、前記接着剤中には、 $10\mu\text{m}$ 以下の平均粒径で分散されたゴム粒子と、フィルム形成性高分子と、エポキシ樹脂と、潜在性硬化剤とを含有する回路接続用接着剤であって、

前記ゴム粒子は、平均粒径以下の粒子が粒径分布の 80%以上を占めるシリコン微粒子である回路接続用接着剤。

【請求項 2】

相対峙する回路電極を加熱、加圧によって、加圧方向の電極間を電氣的に接続する加熱接着性接着剤において、前記接着剤中には、硬化後に  $10\mu\text{m}$ 以下の平均粒径で分散されているゴム粒子と、フィルム形成性高分子と、エポキシ樹脂と、潜在性硬化剤とを含有する回路接続用接着剤であって、

前記ゴム粒子は、平均粒径以下の粒子が粒径分布の 80%以上を占めるシリコン微粒子である回路接続用接着剤。

【請求項 3】

DSC (示差走査熱分析) での発熱開始温度が  $60^\circ\text{C}$  以上である、請求項 1 又は 2 に記載の回路接続用接着剤。

## 【請求項 4】

硬化反応の 80 % が終了する温度が 260 である、請求項 1 ~ 3 のいずれか一項に記載の回路接続用接着剤。

## 【請求項 5】

発熱量が 50 ~ 140 J / g である、請求項 1 ~ 4 のいずれか一項に記載の回路接続用接着剤。

## 【請求項 6】

さらに 0 . 2 ~ 30 体積 % の導電粒子を分散させた、請求項 1 ~ 5 のいずれか一項に記載の回路接続用接着剤。